



株主メモ

事業年度 毎年8月1日から翌年7月31日まで
 定時株主総会 10月
 基準日 7月31日
 上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
 配当金支払株主確定日 期末配当金 7月31日
 中間配当金 1月31日
 単元株式数 100株
 上場市場 東京証券取引所プライム市場
 公告方法 電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
 株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社
 同連絡先 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
 電話 0120-094-777 (通話料無料)
 ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)
 1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
 2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
 3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください / コエキク

当社は、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスキー入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。
<https://koekiku.jp>

アクセスキー

スマートフォンからカメラ機能でQRコードを読み取り
 QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝を進呈させていただきます。

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。https://www.pronexus.co.jp/
 アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」☎koekiku@pronexus.co.jp

ホームページのご紹介

<https://www.samco.co.jp/>

トップページ



第44期の売上高・営業利益・当期純利益は過去最高となりました。 最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、 脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第44期（2022年8月1日～2023年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。



左：代表取締役会長兼CEO
辻 理
右：代表取締役社長兼COO
川邊 史

第44期の事業環境、経営成績

半導体等電子部品業界におきましては、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいて、5G（第5世代移動通信システム）の普及に伴い、その「高速・大容量」「低遅延」「多接続」という特色を活かした新たな事業領域での開発投資が幅広い企業で進み、本格生産への移行が進んでおります。加えて、不透明さを増す国際情勢を背景に、各国が自国での半導体産業育成の取り組みを強化しており、半導体等電子部品製造装置の需要は拡大しております。

このような状況の下、当社ではオプトエレクトロニクス分野では顔認証や通信用レーザーダイオード、LED、電子部品・MEMS分野では高周波デバイスやパワーデバイス、量子デバイス用途、シリコン分野では欠陥解析用途、表示デバイス分野では有機ELやVRディスプレイ用途、その他分野では、医療・バイオテクノロジー用途向けの製造装置の販売実績がありました。また、新規事業（ヘルスケア事業）の創出に向けた技術開発への取り組みや、水蒸気を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma（アクアプラズマ）洗浄装置の拡販による新たな事業領域の拡大に注力いたしました。

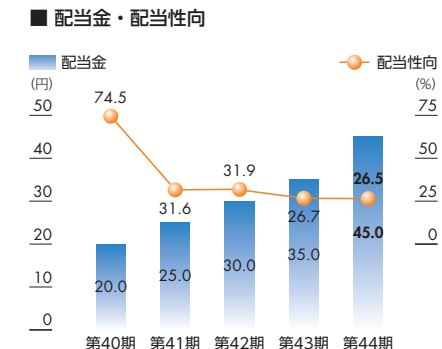
その結果、当期の国内売上高は5,145百万円（前期比24.3%増）となりました。国内では大手デバイス・電子部品メーカー、大学、公的研究機関などからの受注や売上が好調でした。一方、当期の海外売上高は2,685百万円（前期比18.6%

増）となり、アジア、北米を中心とした海外メーカー、大学、研究機関など幅広い地域や顧客からの販路拡大に注力しております。海外売上高比率は34.3%となり、中長期的に目標としている海外売上高比率50%に向け、更なる海外事業の拡大を推進してまいります。

続いて、当期の受注高は8,221百万円（前期比2.1%減）となりました。半導体不足に伴う部材調達の遅れの影響が残るものの、装置受注から出荷までのリードタイムを短縮すべく、DXを活用した受注予測に基づく見込み生産を始めとする生産体制の整備、見直しを進めております。その結果、当期末の受注残高は5,418百万円（前期比7.8%増）となり、次期好スタートの準備が整っております。

以上の結果、当期における業績は、売上高7,830百万円（前期比22.3%増）、営業利益1,858百万円（前期比35.6%増）、経常利益1,927百万円（前期比30.1%増）、当期純利益1,366百万円（前期比29.7%増）となりました。

なお、期末配当金につきましては、経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、1株当たり45円00銭とさせていただきます。



中期経営計画の進捗

当期（第44期）よりスタートした3カ年の中期経営計画を推進中であり、第44期は当初計画どおりの着地となりました。次期（第45期）では、売上高8,500百万円、当期純利益1,370百万円を目標に、全社を挙げて取り組んでまいります。

当社では、創業当初から半導体の材料の研究に取り組み、省エネや脱炭素社会の実現に貢献してまいりました。IoT、AIなどの技術革新に伴い、サムコの「薄膜技術」から生み出されるLEDやレーザーダイオード、パワーデバイス、センサーといった製品は省エネや脱炭素社会の実現に向けて、ますます必要とされるものとなっております。最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



サムコ株式会社とは？

サムコは京都市伏見区に本社を置く**半導体等電子部品の製造装置を手掛けるメーカー**です。半導体や電子部品は皆様の快適な暮らしには欠かせないものとなり、当社では薄膜を微細加工するエッチング装置、薄膜を形成するCVD装置・ALD装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの独自の製品を世界中に提供しています。

社名の**SAMCO(サムコ)**は、**Semiconductor And Materials COmpany**の略であり、半導体と材料開発の分野で躍進していくことを目指して名付けられています。



グローバルに事業を展開

1979年の創業以降、世界各国でグローバルに事業を展開しており、現在はアジア、北米、欧州を中心に営業支店や子会社、販売代理店など、海外に11拠点を有しております。また、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供すべく、「直接販売」を行っており、京都から独自の製造装置を世界中に送り続け、これまで**世界35カ国に4,400台の装置を販売**してきました。



サムコが注力する化合物半導体とは？

当社は半導体の中でも“**化合物半導体**”と呼ばれる材料に特化した装置メーカーです。化合物半導体は、一般的に半導体で使用されるシリコン（珪素）とは異なり、複数の元素を組み合わせで作られる半導体で、高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っています。



化合物半導体はどんなところに使われている？

化合物半導体は身の回りの様々なところに活かされており、今後、更なる市場の拡大が見込まれています。**当社の装置を使って製造されるデバイスや最終製品の事例**を、当社の用途別にご紹介いたします。

	製造されるデバイス	最終製品の事例
オプトエレクトロニクス分野	LED (発光ダイオード) LD (半導体レーザー)	3D顔認証システム 5G・次世代通信、光通信
電子部品・MEMS分野	F-BAR (高周波フィルタ) パワーデバイス	スマートフォン・ウェアラブル端末 自動運転・電気自動車

省エネ・脱炭素社会を支えるサムコの技術

化合物半導体が用いられるLEDや次世代パワーデバイスなどは、当社の“**薄膜技術**”が活かされた装置によって製造されており、**当社は省エネ・脱炭素社会を支えているメーカー**であると言えます。持続可能な社会の実現に向けて、サステナブルな企業価値創造を目指し事業を展開しております。

詳しくは当社ホームページ
<https://www.samco.co.jp/ir/info/csr/>



TCFD | TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

広報誌サムコナウの紹介

当社では、「**研究者の皆様と産業界の橋渡し**」をコンセプトにした広報誌**サムコナウ (samco NOW)**を四半期に一度発行しています。ユーザーの皆様インタビューや、最新の技術、京都のお食事処など盛り沢山の内容となっており、バックナンバーも公開しておりますので、ぜひアクセスをお願いします。

<https://www.samco.co.jp/company/samconow/>



決算ハイライト

売上高
7,830百万円

前期比 **22.3%**増 ↑

計画比 **1.7%**増 ↑

営業利益
1,858百万円

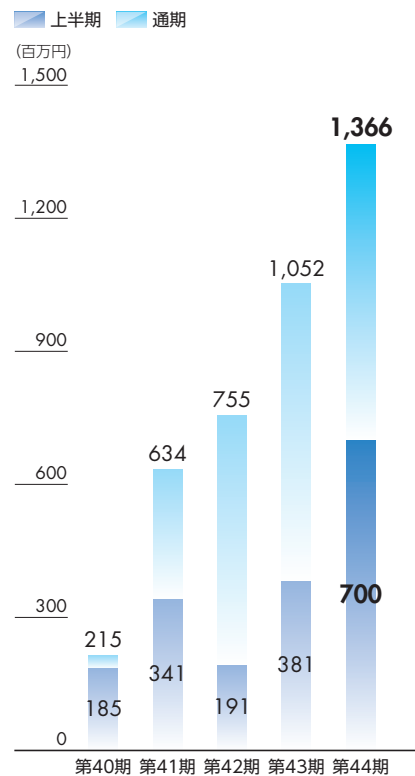
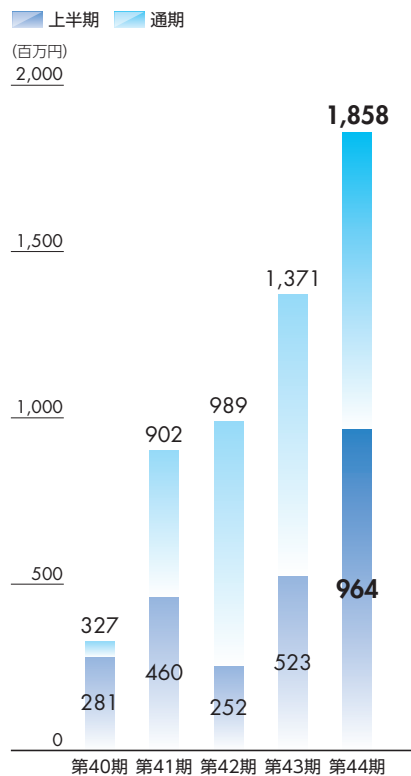
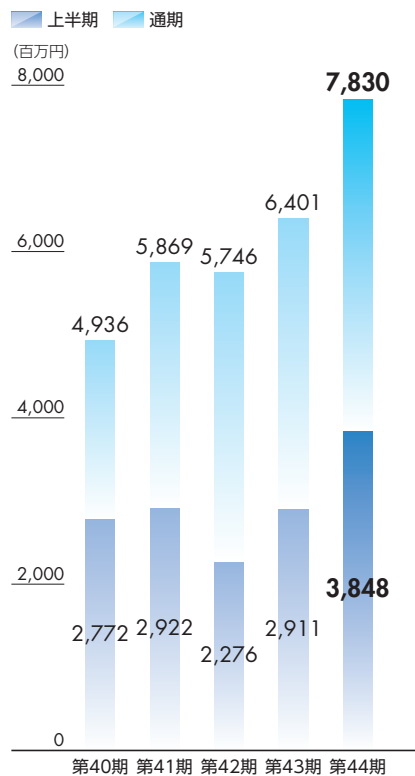
前期比 **35.6%**増 ↑

計画比 **14.8%**増 ↑

当期純利益
1,366百万円

前期比 **29.7%**増 ↑

計画比 **26.5%**増 ↑



財務諸表

貸借対照表

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (2023年7月31日現在)	前期 (2022年7月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	10,175,585	8,840,448
固定資産	4,619,445	4,539,192
有形固定資産	3,863,459	3,815,865
無形固定資産	4,364	4,934
投資その他の資産	751,621	718,392
資産合計	14,795,031	13,379,640
(負債の部)		
流動負債	2,676,039	2,314,240
固定負債	974,736	1,007,868
負債合計	3,650,775	3,322,108
(純資産の部)		
株主資本	10,993,640	9,909,873
評価・換算差額等	150,615	147,658
純資産合計	11,144,255	10,057,532
負債・純資産合計	14,795,031	13,379,640

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自2022年8月1日 至2023年7月31日)	前期 (自2021年8月1日 至2022年7月31日)
売上高	7,830,591	6,401,870
売上原価	3,961,565	3,212,022
売上総利益	3,869,026	3,189,847
販売費及び一般管理費	2,010,032	1,818,641
営業利益	1,858,994	1,371,206
営業外収益	72,439	114,302
営業外費用	4,268	4,103
経常利益	1,927,165	1,481,405
税引前当期純利益	1,927,165	1,481,405
法人税、住民税及び事業税	570,239	377,510
法人税等調整額	△ 9,202	50,984
当期純利益	1,366,127	1,052,910

キャッシュ・フロー計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科目	当期 (自2022年8月1日 至2023年7月31日)	前期 (自2021年8月1日 至2022年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,395	1,181,167
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,930	△ 214,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,194	△ 64,106
現金及び現金同等物の期末残高	3,374,374	3,919,589

新製品

クライオICPエッチング装置「RIE-800iPLN」の販売を開始

1月、液体窒素を用いたマイナス150度の極低温エッチングを可能としたクライオICPエッチング装置「RIE-800iPLN」を開発、販売を開始いたしました。半導体の微細化・高積層化に伴って、エッチング技術に求められる要求は高まっており、それらの要求に応えるため当装置を開発いたしました。今後も顧客のニーズに対応した新製品を開発していく計画です。



新製品

本格量産装置「クラスターH™」の初号機を納入完了

電子デバイス製造のエッチング工程向けの本格量産装置「クラスターH™」の初号機を、国内の電子部品メーカー様に納入し、各種生産データの収集及び装置・ソフトのブラッシュアップを図りました。クラスター装置とは、搬送プラットフォームを中心に複数の反応室を接続できる大型装置であり、今後の生産機市場でのシェア拡大のために更なる拡販を進めてまいります。



展示会

世界各国のSEMICONショーに出展

当社では重点課題の1つに「海外事業の拡大」を掲げており、海外での展示会にも積極的に出展しております。昨年11月のSEMICON Europa (ドイツ)、昨年12月のSEMICON Japan (日本)、3月のSEMICON China (中国)、7月のSEMICON West (米国)、9月のSEMICON Taiwan (台湾)などに出席し、最先端技術の紹介や製品発表などを実施いたしました。



SEMICON Westの当社ブース

社会貢献

ウクライナ人道危機救援金への寄付を実施

当社では2001年の株式会社店頭上場以降、毎期の利益の一部を日本赤十字社などの各種団体に寄付する活動を続けております。ロシアによるウクライナ侵攻の収束の見通しが立たない中、ウクライナや周辺国において救援活動に取り組んでおられる赤十字社の活動にお役立ていただくため、本年7月、日本赤十字社へ1,000万円を寄付いたしました。



社会貢献

ISPC-25が京都で開催

5月21日～26日、京都市勧業館みやこめっせでISPC-25 (25th International Symposium on Plasma Chemistry、第25回プラズマ化学国際シンポジウム) が開催されました。当社は二条城で開催されたWelcome Receptionを後援するとともに、5件のポスター発表を行いました。ISPCは1973年にドイツで開催されて以降、50年の歴史を誇る「プラズマ化学」における世界的な学会であり、当社会長の辻は開催当初より関与しております。

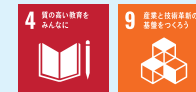


Welcome Receptionにて
当社会長 辻、京都市長 門川大作様ら

社会貢献

サムコ科学技術振興財団が 2023年度 第7回研究助成者7名に研究助成金を贈呈

サムコ科学技術振興財団は、第7回 薄膜技術に関する研究助成の対象者7名を決定し、9月13日に開催されました研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額1,400万円を贈呈いたしました。式典後には、ネオジム磁石の発明者である大同特殊鋼株式会社顧問で、NDFEB株式会社 代表取締役の佐川真人様による記念講演が行われました。



※研究助成対象者7名とその研究課題につきましては財団のホームページをご覧ください。<https://www.samco.co.jp/foundation/prize/>

■ 会社概要

商号 サムコ株式会社 (英文：SAMCO INC.)
 設立 1979年 (昭和54年) 9月
 事業内容 半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
 資本金 1,663,687,288円
 従業員数 175名
 本社 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 TEL (075) 621-7841 FAX (075) 621-0936
 国内拠点 本社 (京都)、東日本営業部 (東京)、東海支店 (愛知)、つくば営業所 (茨城)
 海外拠点 米国 (カリフォルニア・ニュージャージー)、台湾、シンガポール、中国 (上海・北京)、マレーシア
 研究拠点 本社研究開発センター (京都)、オプトフィルムス研究所 (米国)

■ 役員 (2023年10月24日現在)

代表取締役会長兼CEO 辻 理
 代表取締役社長兼COO 川 邊 史
 取締役専務執行役員 山下 晴彦
 取締役執行役員 宮本 省三
 佐藤 清志
 社外取締役 村上 正紀
 高須 秀視
 藤田 静雄
 常勤監査役 辻村 茂
 社外監査役 木村 隆之
 西尾 方宏
 常務執行役員 外山 信一
 執行役員 本山 慎一
 松出 和男
 ヘンリー・チャン
 上杉 能章
 江崎 裕二

■ 株式の状況

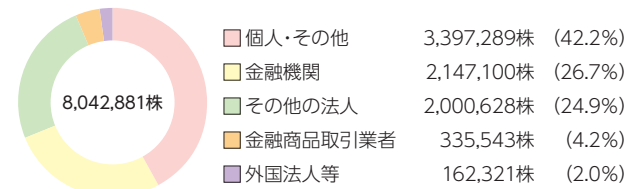
発行可能株式総数 14,400,000株
 発行済株式の総数 8,042,881株
 株主数 8,158名

大株主の状況

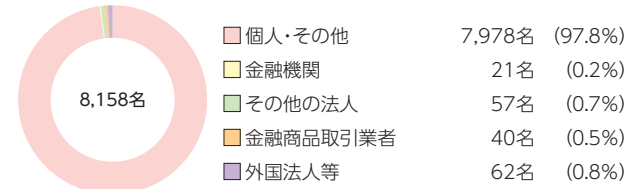
株主名	持株数(株)	持株比率(%)
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	878,007	10.9
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	866,700	10.8
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
(株)日本カストディ銀行(信託口)	441,900	5.5
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行(株)(投信口)	144,700	1.8
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	104,438	1.3
立田 利明	103,099	1.3

■ 所有者別株式分布状況

株式数



株主数



株主各位

京都市伏見区竹田藁屋町36番地
 サムコ株式会社
 代表取締役社長 川 邊 史

第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第44期 (2022年8月1日から2023年7月31日まで) 事業報告及び計算書類報告の件
 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当として1株につき45円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「第44期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局 (銀行代理業者) において払渡し期間内 (2023年10月25日から2023年11月30日まで) にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「第44期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上